

国際シンポジウム “鉛フリーはんだ京都サミット2008”

Int'l Sympo on Lead-Free Solder-Kyoto Summit 2008 (ISLS-KS2008)

2008年5月2日(金) 11:00~17:40

プログラム

11:00-11:05	開 会 挨 拶	京都大学 副学長・工学研究科 教授・副学長	松重 和美
11:05-11:20	来 賓 挨 拶	経済産業省 商務情報政策局 参事官	星野 岳穂
11:20-11:40	基 調 講 演	『高温鉛フリーはんだと環境に関する産学官連携の取組み』 京都大学 副学長・工学研究科 教授・副学長	松重 和美
11:40-12:10	『米国における鉛フリーはんだの動向と今後のビジョン』	IPC 米国電子機械工業会 副会長	David Bergman
12:10-12:40	『欧州における鉛フリーはんだの動向と今後のビジョン』	国際 Tin Technology 協会 取締役	Kay Nimmo
	休 憩 (12:40-13:40)		
13:40-14:10	『鉛フリーはんだの誕生と未来への進化』	松下電器産業(株) 生産革新本部 主幹技師	末次 憲一郎
14:10-14:40	『鉛フリー対応材料の展開：半導体パッケージから電子機器回路まで』	ハリマ化成(株) 電子材料事業部企画部 部長	小山 賢秀
14:40-15:10	『鉛フリーはんだの開発と将来への展望』	三井金属鉱業(株) 経営企画室 室長補佐	二宮 隆二
	休 憩 (15:10-15:40)		
15:40-16:10	『高温鉛フリーはんだ付けに対する取り組み』	日立製作所(株) 生産技術研究所 主管研究員	芹沢 弘二
16:10-16:40	『鉛フリーはんだ実用化までの道筋と展望』	河野エムイー研究所 代表取締役	河野 英一
16:40-17:10	『鉛フリーはんだ導入の経緯と次世代材料の展望』	ソニー(株) モノ造り技術センター 先端実装技術マネジャー	荒金 秀幸
17:10-17:40	特別貢献賞 (Special Recognition Award) 授賞式		
17:50~	レセプション		